

2021年6月9日

報道関係各位

PALTEK SOLUTION SUPPLIER
PALTEK
プレスリリース
株式会社 P A L T E K

PALTEK、「第2回 関西物流展」に出展 ～紙が物流コストと環境問題を変えていく～

株式会社 P A L T E K（本社：横浜市港北区、代表取締役社長：高橋忠仁、証券コード：7587、以下 P A L T E K）は、2021年6月16日（水）から6月18日（金）まで、インテックス大阪で開催される「第2回 関西物流展」に出展し、「紙が物流コストと環境問題を変えていく」をテーマに、Ranpak 株式会社（以下 Ranpak）の紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進について提案します。

新型コロナウイルスの感染拡大に影響により、EC・物流業界は大きく様変わりしました。巣ごもり需要の増加などによりネットショッピングの利用が拡大し、物流量は大幅に増加するなかで、EC 事業者や物流事業者では出荷作業のオートメーション化などの物流生産性向上が求められています。また、世界的な「脱プラスチック」の流れは加速しており、プラスチック系の梱包資材の使用を控える動きなども顕著になっています。



展示会出展ブースイメージ

P A L T E Kの提供するRanpakの紙梱包資材はプラスチック製品の梱包資材の置き換えが可能のため、食料品や雑貨・日用品を扱う通信販売や実店舗での採用に加え、電子機器などの精密機器や医薬品など、さまざまな商品の緩衝材として採用が広がっています。Ranpakの紙梱包資材は、独自の技術により高い緩衝能力を発揮し、梱包方法の最適化により梱包資材コストの低減、資材保管スペースの縮小、梱包作業の高速化による労働コストの削減などのトータルコストの大幅な削減が可能となります。

「第2回 関西物流展」は、物流業界では労働人口の減少・高齢化、労働環境の悪化など深刻な課題が山積する中、物流における最先端の情報が集まり、活発な商談や議論が行われる場が欲しいという業界関係者の声を受けて立ち上がりました。物流業界の「生産性向上」、「環境改善」にスポットを当て、課題解決、更なる発展に向けたきっかけとなる場を創ることを目的とした展示会です。

PALTEKブースでは、2020年6月に日本国内で販売を開始した次世代緩衝材システム「PadPak®Guardian」の実演やラッピングシステムなどを展示し、Ranpakの紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進を提案します。また、新たに梱包自動化ソリューションとして、資材コスト・季節による需要の変動、パレットの積載効率・積荷の最適化など、お客様のコスト全体に影響を及ぼす要素の改善を提案します。

■ 展示会の概要

- 展示会名 : 第2回 関西物流展
開催日時 : 2021年6月16日(水)から6月18日(金)
10:00~17:00 (最終日18日のみ16:00まで)
※新型コロナウイルスの影響により、当初の2020年10月から2021年6月に会期が延期されました。
- 会場 : インテックス大阪 6号館 (大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102)
PALTEKブースは、B2-31
- 主催 : 関西物流展 実行委員会
- 展示会URL : <https://kansai-logix.com/>
- 来場事前 : <https://kansai-logix.com/entry/>
- 登録URL (ご来場の際には招待券または事前登録が必要となります。)

■ 主な出展内容

- 次世代緩衝材システム: PadPak®Guardian

「PadPak®Guardian」は、梱包速度の向上によるコスト削減に加え、C字型に折り畳まれたペーパーを採用したことにより、緩衝材の補充作業など使い勝手のよい操作性を提供します。

これにより、電子・電気部品から自動車用スペアパーツや産業機械設備などの重量のある商品まで、幅広い商品の梱包ニーズに応えます。



次世代緩衝材システム
「PadPak®Guardian」

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/padpak/padpak_guardian/index.html

・高速すき間埋めシステム:FillPak®

「FillPak®」は、配送箱と製品とのすき間を高速に埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋めることが可能です。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/fillpak/index.html>



高速すき間埋めシステム「FillPak®」

・ラッピングシステム:Geami WrapPak®

「Geami WrapPak®」は、特許を取得したダイカット（切り込み）入りクラフト紙と台紙の組み合わせで商品を守り、迅速な梱包と美しい見た目を両立します。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/geami_wrappak/index.html



ラッピングシステム「Geami WrapPak®」

・梱包自動化ソリューション

梱包自動化ソリューションの一つである、「Pad'it!」は、梱包ラインの効率を高める、特殊な自動梱包機です。高品質な紙緩衝材を直接箱にセットすることにより、輸送中の壊れやすい製品を保護します。箱の底サイズに合わせ、1時間あたり最大900箱に紙緩衝材を作成し、製品保護を改善し自動化します。消費材、美容・ヘルスケア、事務用品、グラフィックアート、電気/電子機器、工具・機器類など幅広い業界で使用されています。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.ranpak.com/jp/automation-solutions/>



梱包自動化ソリューション

■ Ranpak株式会社について

Ranpakは世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する紙梱包資材を提供することを目標に1972年に設立され、世界に230社以上の代理店、400箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包資材・システムメーカーです。40年以上にわたる経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を400以上有し、世界で6万社のユーザーに提供しております。Ranpak BVは、欧州およびアジアに100以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリスなど）の成熟市場、東ヨーロッパ（ポーランド、スロバキア、トルコ）の発展途上市場、およびアジア太平洋（オーストラリア、日本、シンガポールなど）など、世界中に拠点があります。

Ranpakに関する詳細は、<https://www.ranpak.com> をご覧ください。

■ 株式会社PALTEKについて

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェア等の設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■ この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1：プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者： 広報担当 柴崎、寺田

メールアドレス： pr@paltek.co.jp

所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F

電話： 045-477-2072

2：本展示会に関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者： 第2回 関西物流展 担当者

メールアドレス： info_pal@paltek.co.jp

所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 11F

電話： 045-477-2009